

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.10B**條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命

Nexchip Semiconductor Corporation

合肥晶合集成電路股份有限公司

執行董事兼董事長

蔡國智先生

香港，2026年8月24日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

合肥晶合集成电路股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司完成H股发行上市后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。公司结合前述变更注册资本事项及公司实际情况，修订《公司章程》。公司将在审议程序完成后及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》的变更、备案等手续。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

修订《公司章程》中涉及管理层设置调整的相关条款尚需提交公司股东会审

议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2026-028)。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2026 年半年度报告及其摘要, 其中 A 股半年度报告包括半年度报告全文及摘要, H 股半年度报告包括中期业绩公告和中期报告。

表决情况: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案已经第二届董事会第十八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成 2026 年半年度报告》和《晶合集成 2026 年半年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金进行了专户存储与专项使用, 及时履行信息披露义务。《晶合集成 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-029)。

(四) 审议通过《关于<公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会同意公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容。

表决情况: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023 激励计划》”）等相关规定，《2023 激励计划》预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为 141,613 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023 激励计划》的相关规定为符合条件的 5 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

（六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意公司作废合计 893,765 股不得归属的限制性股票。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

（七）审议通过《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成

的议案》

同意提名杨国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意相应调整公司第二届董事会专门委员会组成。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

董事及独立董事任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过，补选董事及独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任方华女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

高级管理人员任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。

（九）审议通过《关于申请新项目自动化设备及生产系统预算的议案》

同意新项目自动化设备及生产系统预算申请。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于申请厂房租赁项目预算的议案》

同意厂房租赁项目新增预算申请。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《关于公司拟参与投资晶汇新芯基金的议案》

同意公司作为有限合伙人，出资 5,000 万元参与投资苏州工业园区晶汇新芯创业投资合伙企业（有限合伙）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日